

印度總理：半導體聚落逐漸成形—「印度正打造完整電子產業價值鏈」

駐印度代表處教育組

印度總理莫迪 2026 年 7 月 4 日（週六）表示，印度正致力於打造涵蓋終端產品、電子零組件到半導體的完整電子產業價值鏈，作為邁向「已開發印度（Viksit Bharat）」的重要藍圖。

莫迪表示：「印度年輕世代將憑藉『印度製造（Made in India）』晶片，驅動人工智慧（AI）、機器人及下一代科技革命。」他指出：「薩南德工廠每年將生產 2 億顆晶片，並已訂下年產量提升至 50 億顆晶片的目標。隨著我國第三座半導體工廠開始商業化晶片封裝生產，印度半導體產業再向前邁進一步。」

莫迪是在主持 CG Semiconductor 位於薩南德的委外半導體封裝與測試（OSAT）工廠啟用典禮時發表上述談話。他表示，「印度半導體計畫（Semiconductor India Programme）」正一步一步、一磚一瓦、一顆晶片接一顆晶片地穩健推進。

CG Semiconductor 已從薩南德 OSAT 廠完成首批商業出貨，產品已運往其日本技術合作夥伴 Renesas（瑞薩電子）的全球客戶。

CG Power 董事長 Vellayan Subbiah 表示，來自菲律賓、南韓、美國及馬來西亞的 75 位以上專業人才，與印度工程師共同合作建立該座工廠，並協助達成瑞薩電子的全球認證標準。他並指出，在人工智慧快速普及之際，印度應持續強化先進製造能力，以創造更多就業機會。

莫迪將此專案形容為印度、日本與泰國企業合作的成果，並表示：「這代表著技術、信任與夥伴關係。」他認為，此合作將加速印度實現半導體發展目標。

他進一步指出：「全球工業強國從來不是靠單一工廠建立起來的。」莫迪表示：「工業強國的形成，建立在產業聚落（industrial clusters）之上。美國的矽谷（Silicon Valley）、臺灣的新竹科學園區（Hsinchu Science Park），以及日本的『矽島』（Silicon Island），都充分展現了產

業聚落的重要性。」

他補充說，薩南德如今也正朝著相同方向發展。「短短幾個月內，美光（Micron）與 CG Semiconductor 已相繼在此投產，這代表印度正逐步形成一個半導體產業聚落。」

莫迪表示，發展半導體是印度電子製造業擴張的下一階段。他指出，自 2014 年以來，印度手機產量已成長 33 倍，電子產品總產值增加近 7 倍，電子產品出口則成長約 11 倍。

他表示：「一個產業能催生數百個相關產業，而這些產業將創造數十萬個就業機會，並帶動整個地區的經濟轉型。」莫迪最後表示，除了薩南德之外，印度其他地區的半導體產業聚落也正逐步形成。

撰稿人/譯稿人：駐印度代表處教育組

資料來源：THE TIMES OF INDIA，2026 年 7 月 4 日

<https://www.hindustantimes.com/india-news/entire-value-chain-of-electronics-will-soon-be-in-india-pm-101783189059980.html>

